

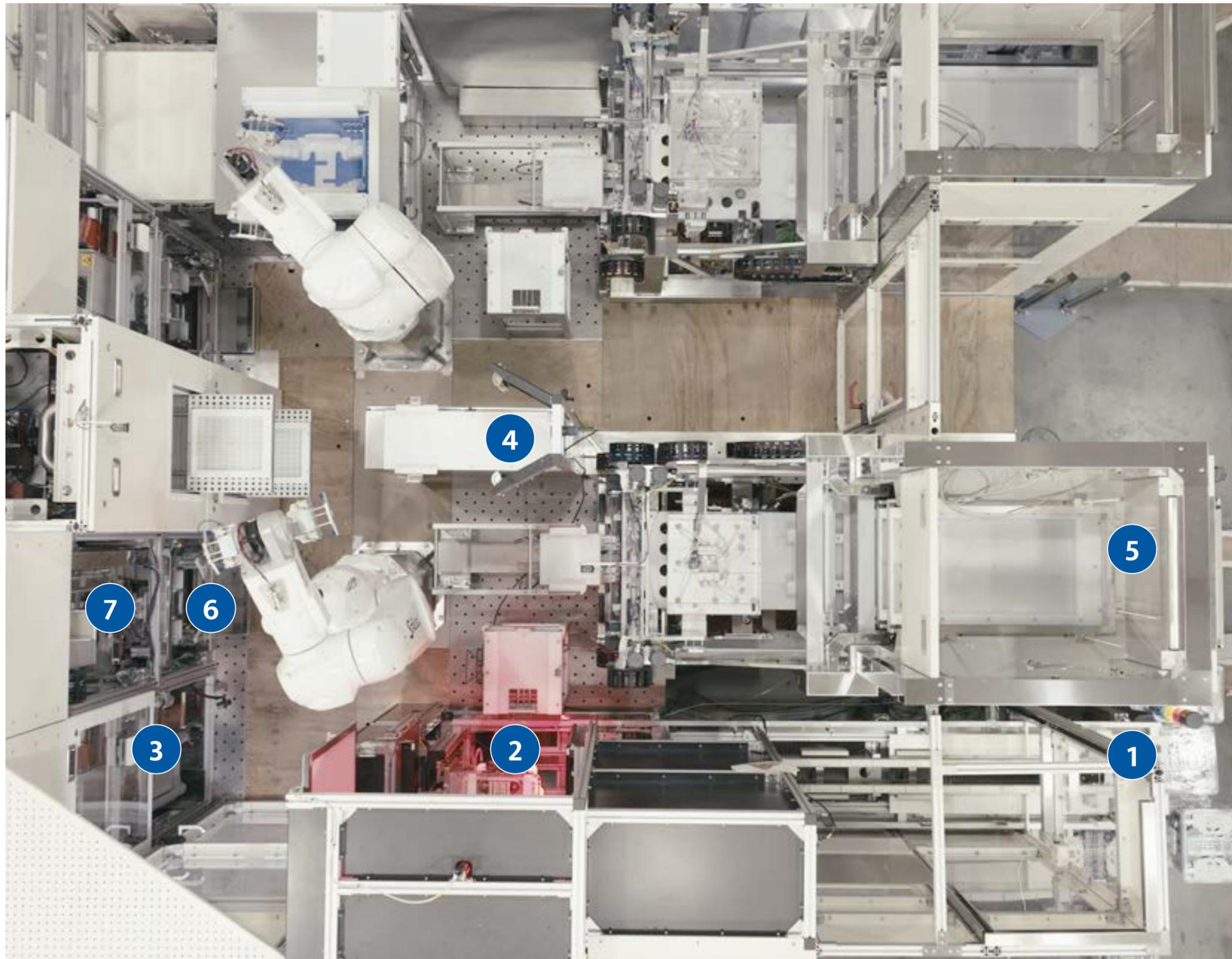


VOLLAUTOMATISCHE LÖSUNG ZUR FOSB-VERPACKUNG

Vollautomatisch. Sicher. Effizient.



Die Verpackung der Roh-Wafer für den Transport in ein Halbleiterwerk (FAB) ist ein aufwändiger Prozess und unterliegt strengsten Kriterien. Wir haben den Verpackungsvorgang voll automatisiert! Unser AutoBagging-Tool (ABT) erhöht deutlich den Durchsatz und bietet eine beträchtliche Qualitätssteigerung und Sicherheit beim Verpacken. Der Durchsatz liegt bei 3.000 bis 8.000 FOSB/Monat (75k bis 200k Wafer/Monat).



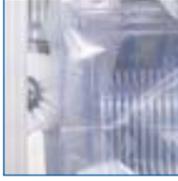
- 

1 Einlaufband
Zuführung der unverpackten FOSBs durch OHT, AMR oder Operator
- 

2 Überprüfung
Cross-Slot-Check und Anbauteileprüfung
- 

3 Labeling FOSB
- 

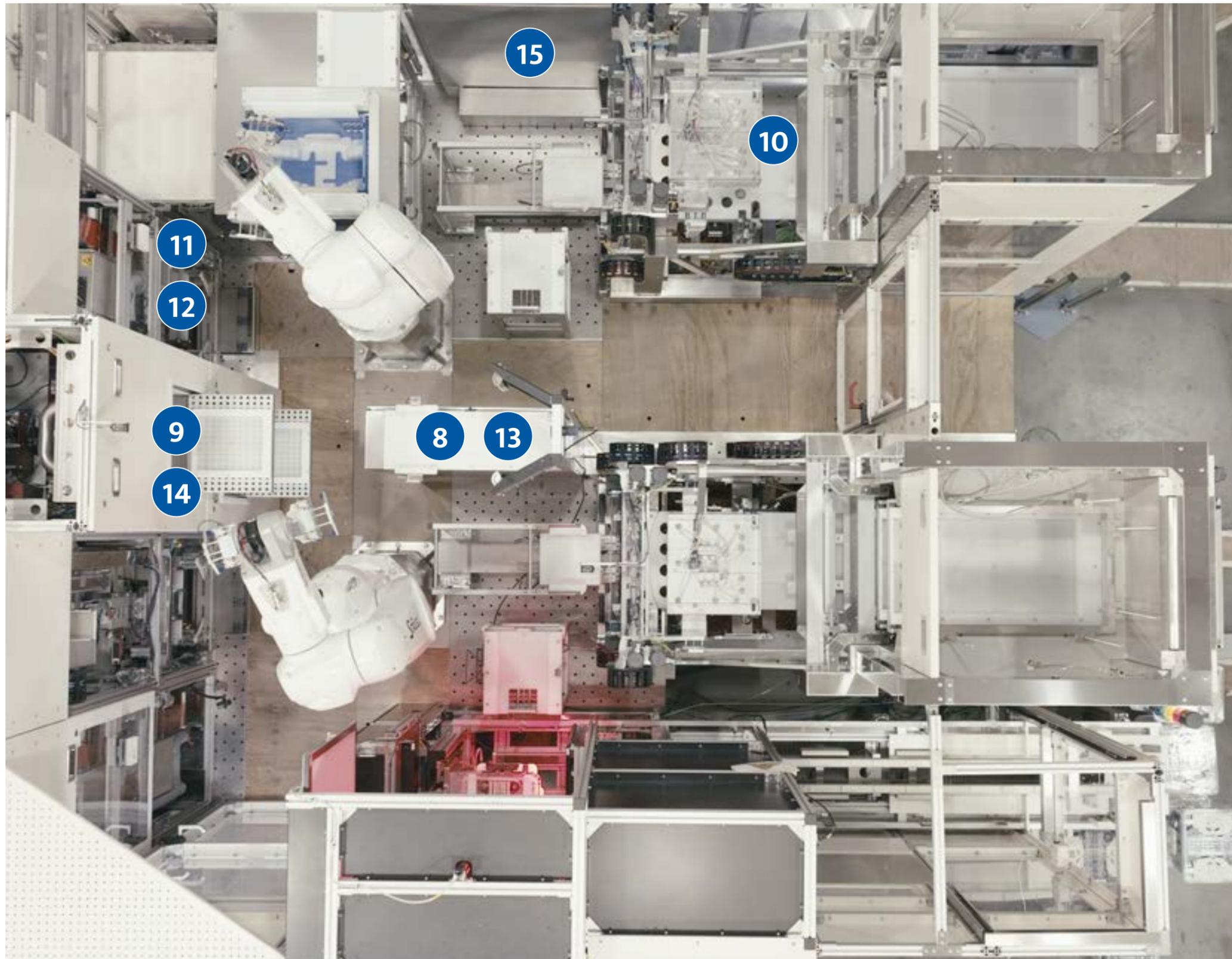
4 Qualitätscheck des Labels
- 

5 Verpacken und Verschweißen innerer Beutel
- 

6 Falten und kleben des Überstandes
- 

7 Labeling innerer Beutel, anbringen Trocknungsmittelbeutel

Die Verpackungsmaschine, die Prüfkammer, die Roboter und alle weiteren Komponenten sind in einer Kompletzzelle platziert. Diese verfügt über ein Zuförderband für die un-
verpackten FOSB sowie ein Ausförderband für die verpackten FOSB. Verschiedene Prüfungen (Cross-Slot, Füllstand, Anbauteile) sowie das Labeln (inkl. Überprüfung des Drucks)
und das Falten/Kleben der Bags erfolgt komplett im ABT.



- 8

Qualitätscheck des Labels
- 9

Dichtheitsprüfung mit Prüfgas
- 10

Verpacken und verschweißen in äußeren Beutel
- 11

Falten und kleben äußerer Beutel
- 12

Labeling äußerer Beutel
- 13

Qualitätscheck des Labels
- 14

Dichtheitsprüfung mit Prüfgas
- 15

Ausförderung



cts GmbH | Fuhrmannstraße 10 | D-84508 Burgkirchen
Tel. +49 (0)8679 91689-110 | factory-automation@group-cts.de | www.group-cts.de